

SlimStack Board-to-Boardコネクター 0.35mmピッチ SSB RPシリーズ

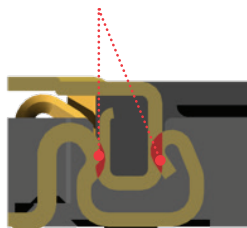
molex

0.35mmピッチSlimStack SSB RP シリーズは、最大定格電流3.0A、メタルカバー付きで、優れた嵌合ガイド機能と電氣的接触を保証するコネクターです。

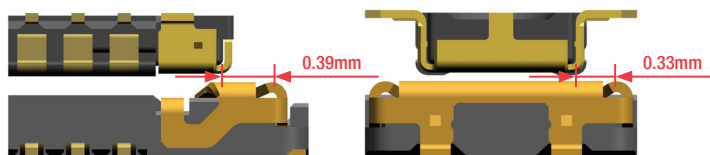
SSB RPシリーズは、タイトなパッケージングニーズに対応すると同時に、設計柔軟性を提供します。基板レイアウトの変更無しで0.60 ~ 1.00mmの嵌合高さバリエーションにも対応。さらに小型化が求め続けられるコンシューマー向けデバイスとともに、マイクロミニチュア部品の設計ニーズも高まっています。

特徴・利点

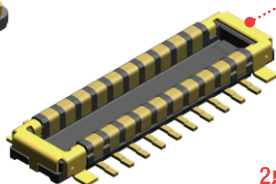
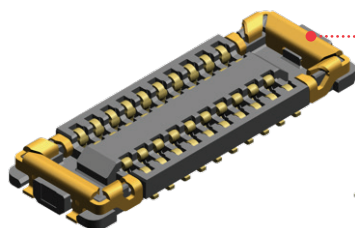
デュアルコンタクト設計
確実な接触信頼性を実現



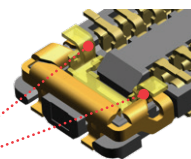
幅広いアライメント
容易で確実な嵌合を実現



堅牢なメタルアーマーネール
ハウジングをダメージから保護し
最大定格電流3.0A



2点接点アーマーネール
2点接点コンタクトにより確実な接触を実現



基板レイアウトの再設計無しで嵌合高さを選択いただけます。

組合せラインナップ		
嵌合高さ (mm)	リセプタクル	プラグ
0.60	505066	505070
0.70	505270	
0.80		505274
0.90		
1.00	505413	

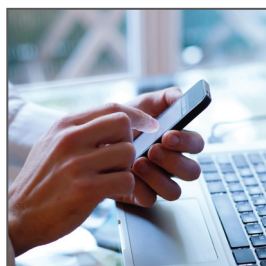
アプリケーション

モバイル機器

スマートフォン
タブレットPC
ウェアラブル機器
ポータブルオーディオ
ポータブルナビゲーション機器

医療用機器

患者監視装置
治療 & 手術装置



スマートフォン



スマートウォッチ



患者監視装置

SlimStack Board-to-Boardコネクター 0.35mmピッチ SSB RPシリーズ

molex

仕様

参考情報

梱包形態: エンボステープング

寸法単位: mm

RoHS: 準拠

ハロゲンフリー: ローハロゲン

電气的性能

最大定格電圧: 50V

最大定格電流:

シグナルコンタクト: 0.3A (1極あたり)

ネールコンタクト: 3.0A (1極あたり)

接触抵抗:

シグナルコンタクト: 80 mΩ以下

ネールコンタクト: 30 mΩ以下

耐電圧: 250V AC

絶縁抵抗: 100 MΩ以上

機械的性能

耐久挿抜回数: 最大30回

材質

ハウジング: LCP、UL 94V-0、黒

コンタクト: 銅合金

メッキ:

コンタクトエリア: 金

半田付け部: 金

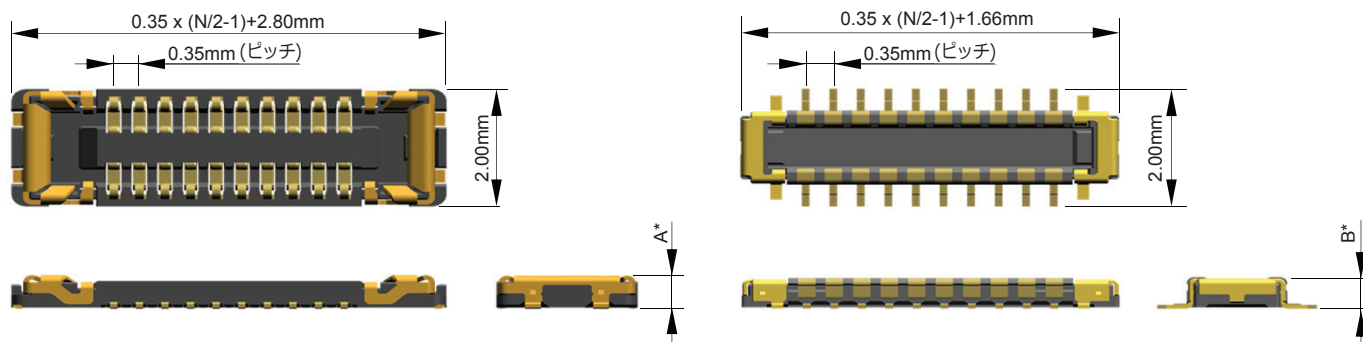
下地メッキ: ニッケル

使用温度範囲: -40 ~ +85°C

寸法

* 詳細寸法は製品図面を参照してください。

N: 極数



オーダーインフォメーション

オーダー番号		嵌合高さ (mm)	嵌合幅 (mm)	極数
リセプタクル	プラグ			
505066-**22	505070-**22	0.60	2.00	6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 30, 34, 40, 42, 48, 50, 54
505270-**12		0.70		6, 10, 16, 20, 22, 24, 30, 34, 40, 54
	505274-**12	0.80		6, 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 54
505413-**10		0.90		6, 30, 34, 40
	505417-**10	1.00		6, 30, 34, 40, 60

**：極数

www.molex.com/link/slimstack.html
www.japanese.molex.com/link/slimstack.html

Molexは、アメリカ合衆国におけるMolex, LLCの登録商標であり、他の国々でも登録されている場合があります。ここに表示されているその他すべての商標も該当する所有者に帰属します。